

「共創型化学会社」 - 世界トップクラスの機能性化学メーカーへの変革 -

株式会社レゾナック・ホールディングス
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）

高橋 秀仁

2025年2月13日

RESONAC

AI半導体への積極投資と共創型イノベーションで 成長基盤を進化させ市場を牽引する

1

Say

半導体成長分野
への積極投資

Do

AI半導体への積極投資で
成長を加速

2

Say

共創型イノベーション
創出加速

Do

R&Dの集約と
社内外共創

3

Say

カルチャー変革
&
人材開発

Do

共創で成長基盤進化

Agenda

- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

Agenda

- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

Purpose

存在意義

化学の力で社会を変える

先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、
グローバル社会の持続可能な発展に貢献する

Values

私たちが大切にしている価値観

- ▶ プロフェッショナルとしての成果へのこだわり
- ▶ 機敏さと柔軟性
- ▶ 枠を超えるオープンマインド
- ▶ 未来への先見性と高い倫理観

RESONAC
Chemistry for Change

レゾナックのめざす姿

共創型化学会社

化学企業としてグローバルにおける一流の実力を備え、
機敏かつ柔軟な行動と意思決定をもって、
産業のキープレイヤーから生活者に至るまで
志を共にする仲間とよりよい社会を共創していく

**世界トップクラスの
機能性化学メーカー**

日本の化学メーカーとして培ってきた良さを活かしつつ、
グローバル企業の高度な経営手法を取り入れることで
様々な社会課題を解決する

レゾナックの長期ビジョン 2030年にめざす姿

2030

Our Vision

- ▶ 世界で戦える会社
- ▶ 持続可能なグローバル社会に貢献する会社
- ▶ 国内の製造業を代表する共創型人材創出企業

Action 2

- ▶ 半導体事業への経営資源集中

Action 1

- ▶ ポートフォリオ改革
- ▶ CXO体制確立

▶ カルチャーの変革&人材開発

達成のための主要戦略

グローバル水準
収益基盤確立

ポートフォリオ
高度化

イノベーション
推進

経営基盤
強化

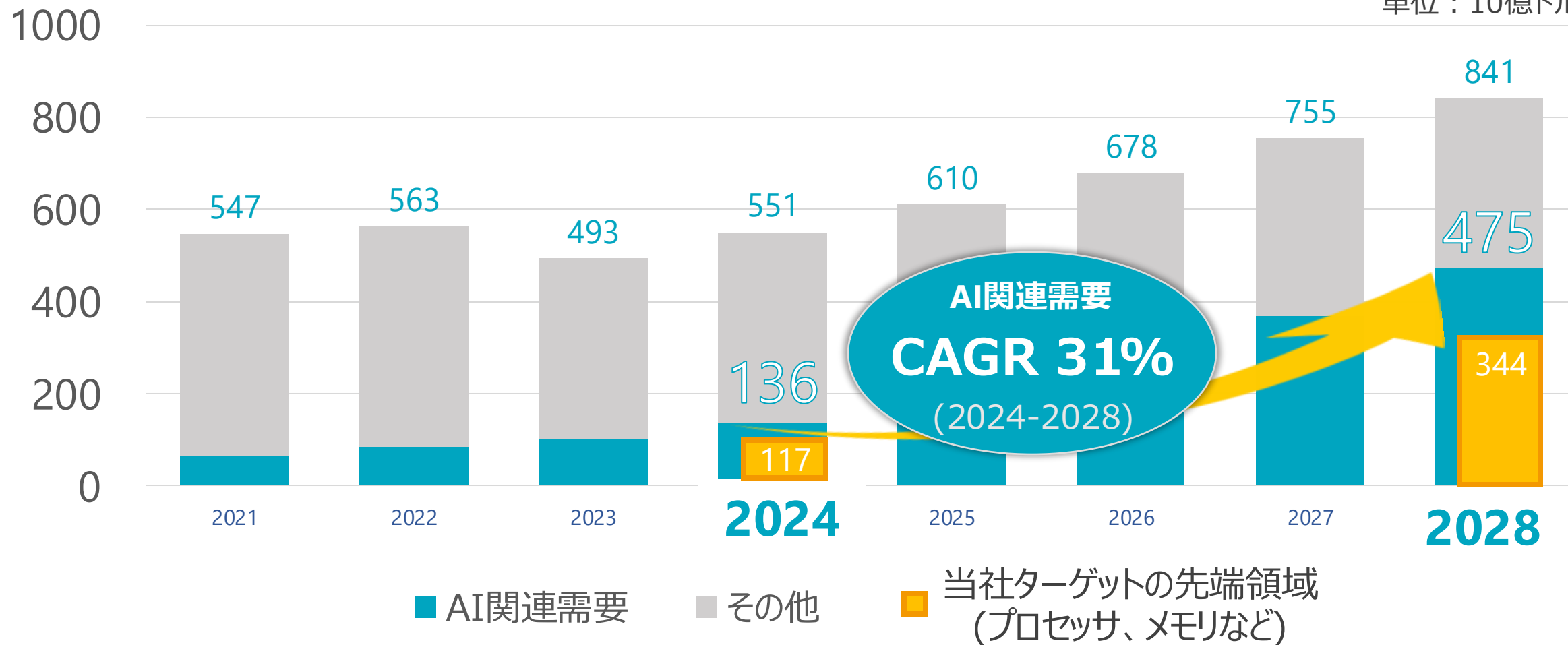
Agenda

- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

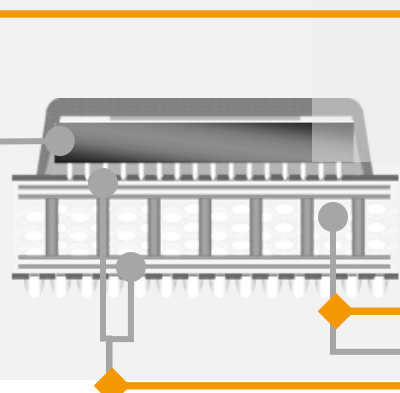
AI関連需要が半導体市場の成長率31%を牽引 急拡大するAI関連需要に対し、確かな製品力で未来を切り拓く

単位：10億ドル

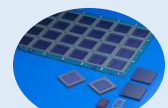


後工程技術を駆使したパッケージ全体での機能実現へ進化 業界をリードする材料と生産基盤の強化で成長を加速

従来半導体



固形封止材



世界シェア2位

ソルダーレジスト
(大型パッケージ基板向け) (パッケージ基板向け)



世界シェア1位

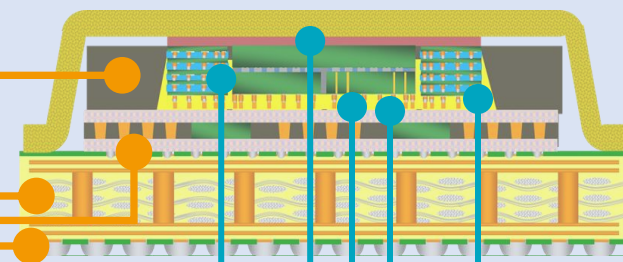
銅張積層板
(パッケージ基板向け)



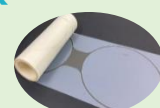
世界シェア1位

順次生産能力
増強中

AI向けプロセッサ

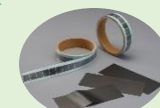


絶縁接着フィルム
(HBM向け)



世界シェア1位

熱伝導材
(シートタイプ)



世界シェア1位

感光性
絶縁材料※



世界シェア1位

液状
アンダーフィル

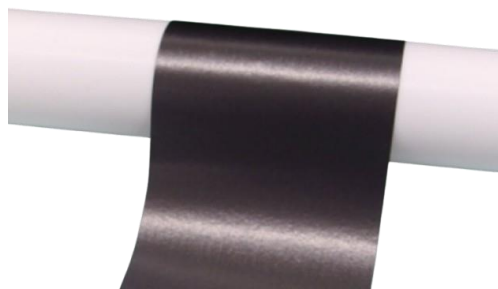


世界シェア2位

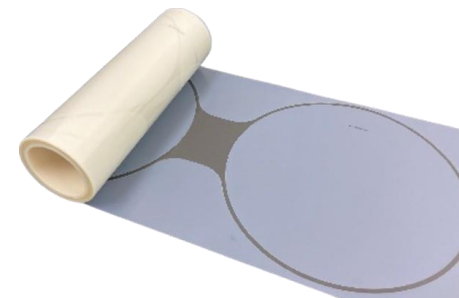
設備投資:能力増強
2023年比 3.5~5倍
(約160億円)

※HDマイクロシステムズ(株)製品含む

独自技術と半導体業界での深い知見
揺るぎない製品力で確固たる競争優位性を維持



熱伝導材「TIM」



絶縁接着フィルム「NCF」

カーボン
縦配向技術

- ・高放熱性を支える縦配向技術
- ・低熱抵抗を実現する密着設計
- ・作業性を高めるシート形状

熱伝導性と温度変化に対する信頼性

最先端
デバイスを支える
差別化
技術

フィルム
薄膜化

- ・極薄形状でHBM *チップ多層化に貢献
- *High Bandwidth Memory

樹脂
設計

- ・狭ギャップ充填による高信頼性担保
- ・放熱特性付与による更なる差別化
- 次世代デバイスへの適用拡大

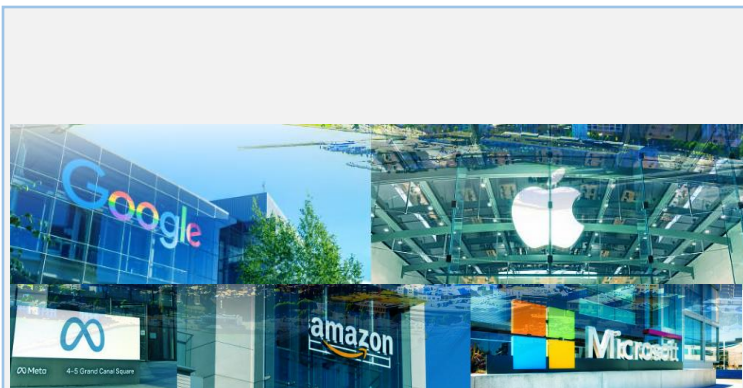
作業性、接続信頼を両立する高機能材料

AI半導体製造プロセスの変化 基板技術が求められるパネルプロセスに対応

業界の流れ

GAFAMの要請

当社提供価値



GAFAMの競争

独自AI半導体開発へ

半導体高集積化

2023

2026

2027

1x

3.5x

> 7x

データ処理能力増加
(パッケージの大型化)

生産性向上

4

24

ウェハプロセス
Φ300mm

パネルプロセス
510mm x 515mm

① 前工程から後工程まで
カバーする製品ラインナップ

- ✓ グローバルトップシェア多数保有
- ✓ 当社材料技術の組み合わせ

② 共創戦略
(グローバルR&D戦略)

- ✓ JOINT2
2.xD構造に関する主要技術確立
- ✓ US-JOINT
米国内次世代半導体パッケージ
技術開発コンソーシアム

Agenda

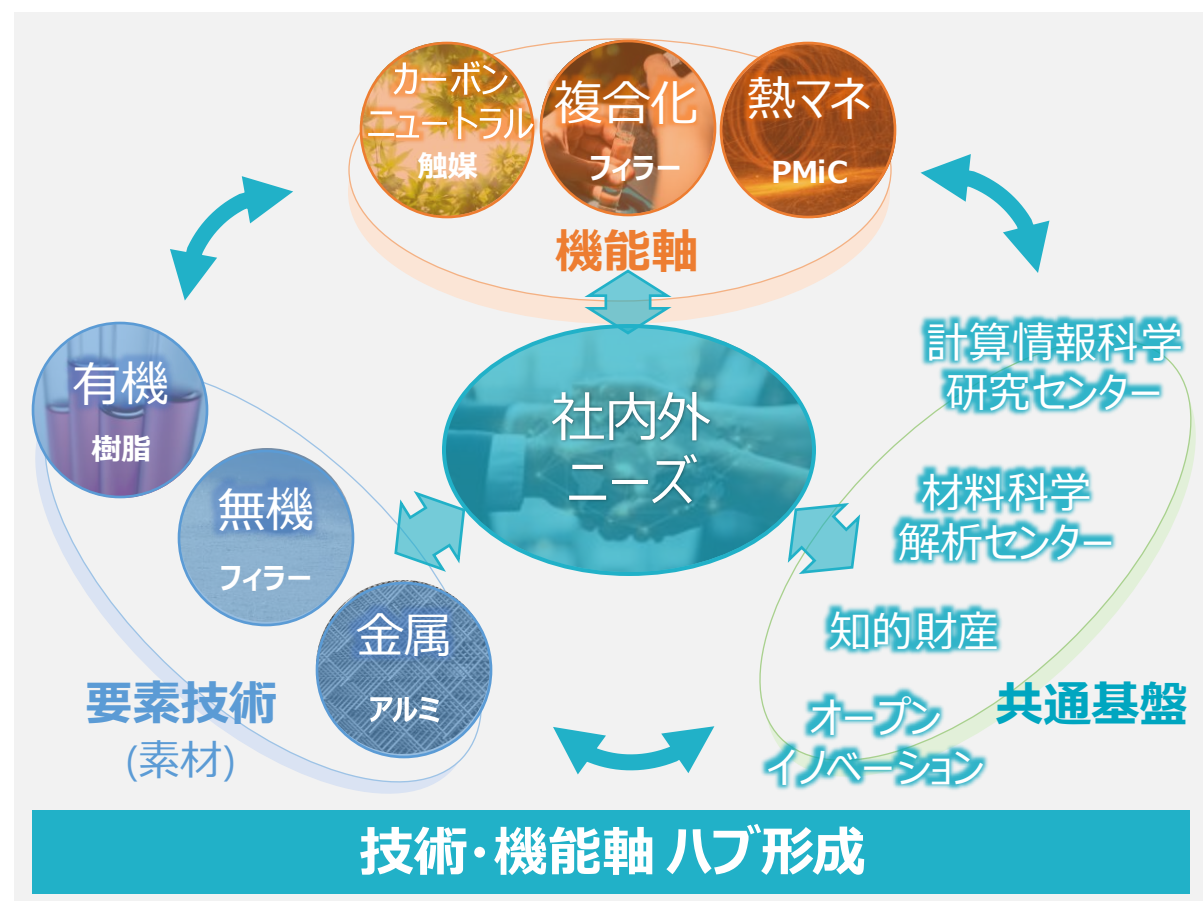
- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

R&Dの集約で全社R&D力を強化 共創でニーズに応える連携基盤を創出

従来

めざす姿



パワーモジュール素材の迅速な採用を実現 性能を発揮する素材・部材の最適な組み合わせを提案



1

試作・実装



様々なタイプの
パワーモジュール

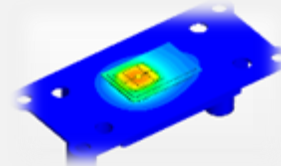
2

性能評価・検証



通電し、**実使用に即した**
状態で測定

シミュレーション



評価結果検証・実験前予測を
行うシミュレーション

3

2025年～
お客さまと共同で評価

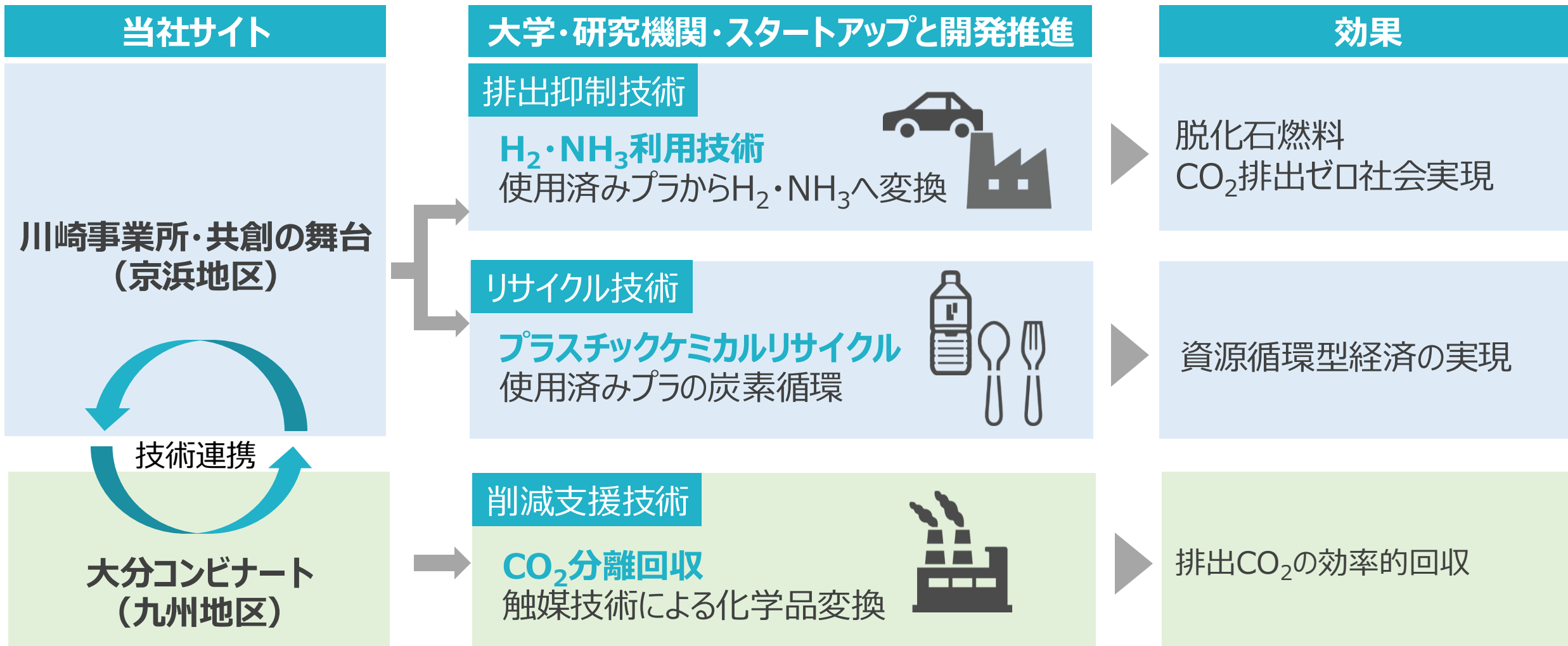
熱マネジメント

燃費や航続距離向上

4

顧客共創サイクル加速

カーボンニュートラル・循環型社会への挑戦 循環型技術と産官学連携で持続可能な価値を創出



Agenda

- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

2022年

～2025年

～2030年

チームで実行

CXO
体制確立

ポートフォリオ改革
万全な収益基盤

より長期的な課題に
CEO自ら注力・推進

価値観を共有し、
変革をやりきる人材が、
適度な緊張感を持ち、
自律的に働く会社

私たち一人ひとりによる
パーパス・バリューの自分ごと化と実践

グローバル人事戦略の展開 後継者計画、育成施策、異動ポリシーの基盤統一で成長を加速

2023

2024

2025

ありたい姿

グローバル展開 本格稼働

グローバル施策 定着拡大

機動的な人材ポートフォリオ 実現

- 国内人事制度統合
- 経営コア人材候補選抜・育成
- 後継者計画
- 共創型リーダーシップ
トレーニング
- 共創型コラボレーション力
強化研修

- 後継者計画
- 管理職グレード・MBO統一
- グローバル共通教育施策
 - リーダシップ研修
 - コラボレーション力強化研修
 - 360度フィードバック など

- 2024施策の対象者拡大
 - グローバル異動ポリシー制定
- 新規施策
国内トライアル**
- ラーニングフェス
 - 社内兼業制度

- グローバルでの適所適材
 - グローバル社内公募制度
 - 戦略的ローテーション など
- グローバル人事制度最適化
- 管理職への権限委譲加速

実行施策を支える人事体制・システム

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ グローバル人事システム稼働 □ HRビジネスパートナー体制稼働 | <ul style="list-style-type: none"> □ 地域統括会社、グローバル体制構築 | <ul style="list-style-type: none"> □ 地域統括会社、グローバル体制強化 □ グローバル人事オペレーション標準化推進 | <ul style="list-style-type: none"> □ グローバルタレントマネジメント体制確立 □ グローバル人事オペレーション最適化 |
|--|--|---|--|

パーパス・バリューの浸透と実践へ 対話、共感、自律を通じた共創の未来

2022

2023

2024

2025

注力
ポイント

- 発信：
経営理念・会社方針
- 認知／理解から共感へ

- 対話：
双方向コミュニケーション
- 共感から実践へ：
バリュー実践
- 心理的安全性：
共創への一歩

- 対話の深化：
相互フィードバック
- 自律：
パーパス自分ごと化
- 枠を超えた共創の実践

- 対話の深化：
相互フィードバック
- 自律：
パーパス自分ごと化
- バリューを意識した
共創の実践

新規
施策

- タウンホールミーティング
- PVカスケードダウン研修
- 共創型コラボレーション力強化研修

- タウンホールミーティング
- モヤモヤ会議
- AHA!
- REBLUC

- パーパス探求カフェ
- AHA!/交流会・講演会
- 360度フィードバック

- 事業所 対話セッション
- AHA!マッチングシステム導入
- マネジャー支援グループ・グローバル展開

共感度 **59%** (+10%)

実践度 **34%** (+10%)

共感度 **66%** (+7%)

実践度 **49%** (+16%)

共感度 **73%** (+7%)

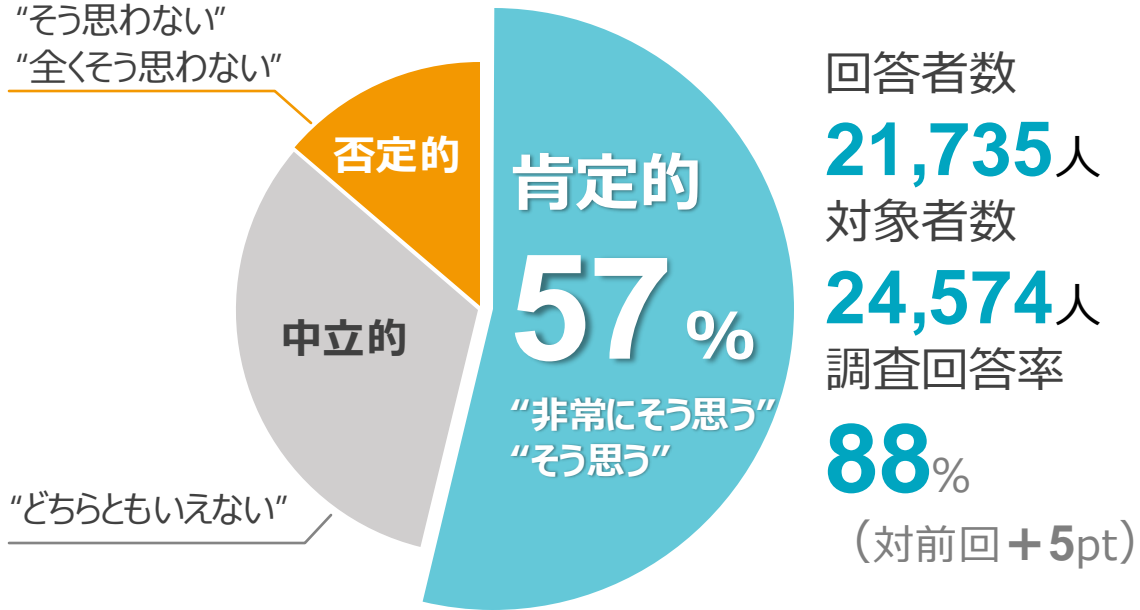
実践度 **60%** (+11%)

共感度 **前年以上**

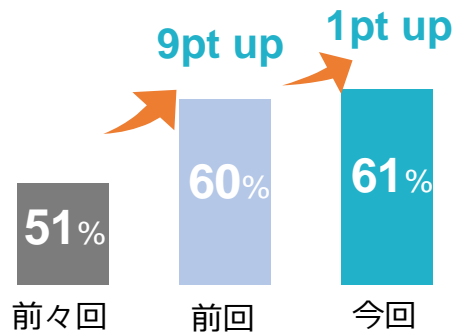
実践度 **前年以上**

パーパス
・バリュー
実践

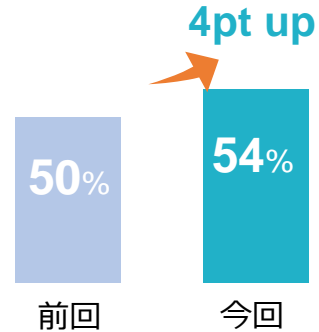
エンゲージメントスコア



心理的安全性

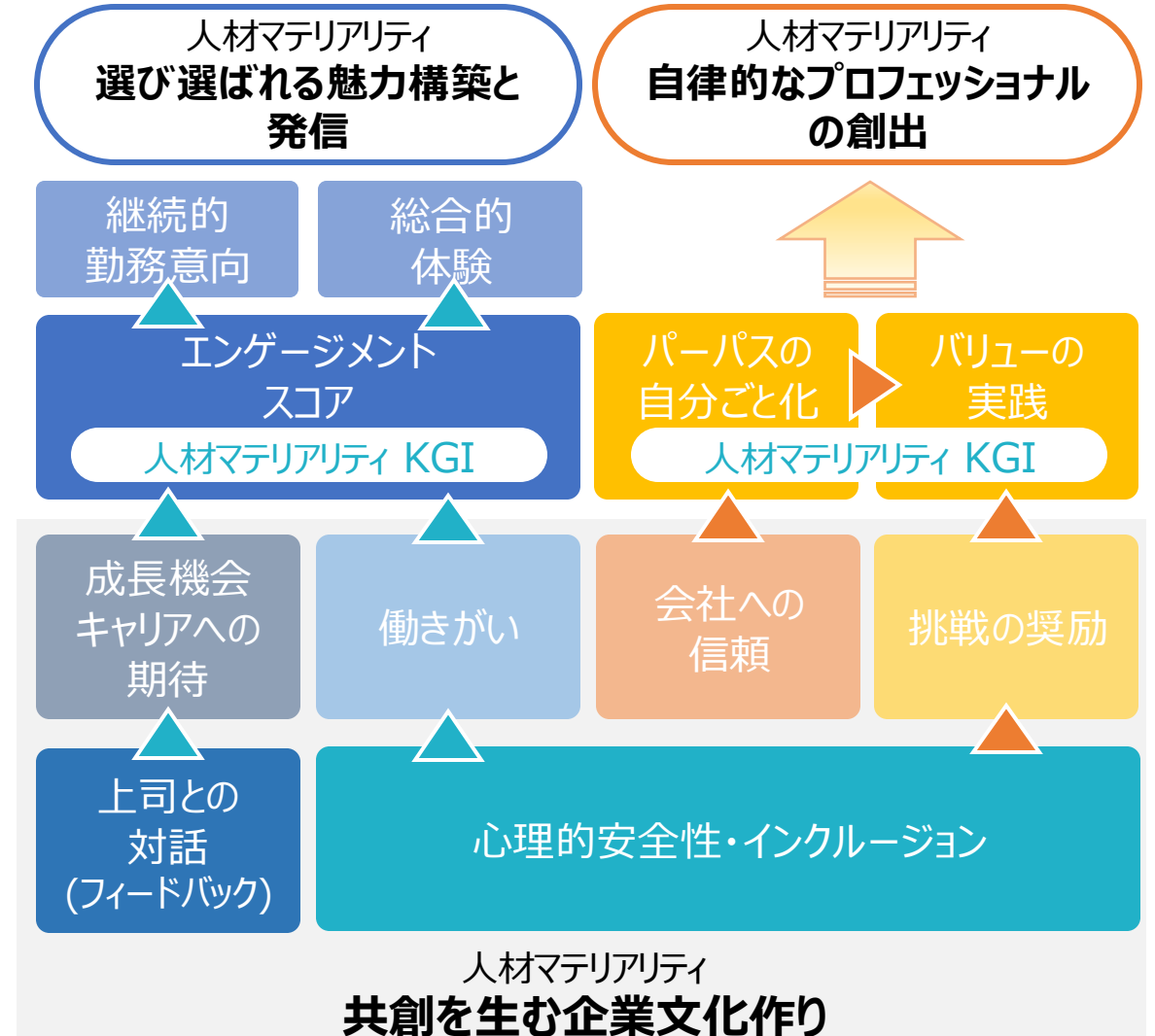


成長の機会



因果探索結果

*日本国内 (2024年)

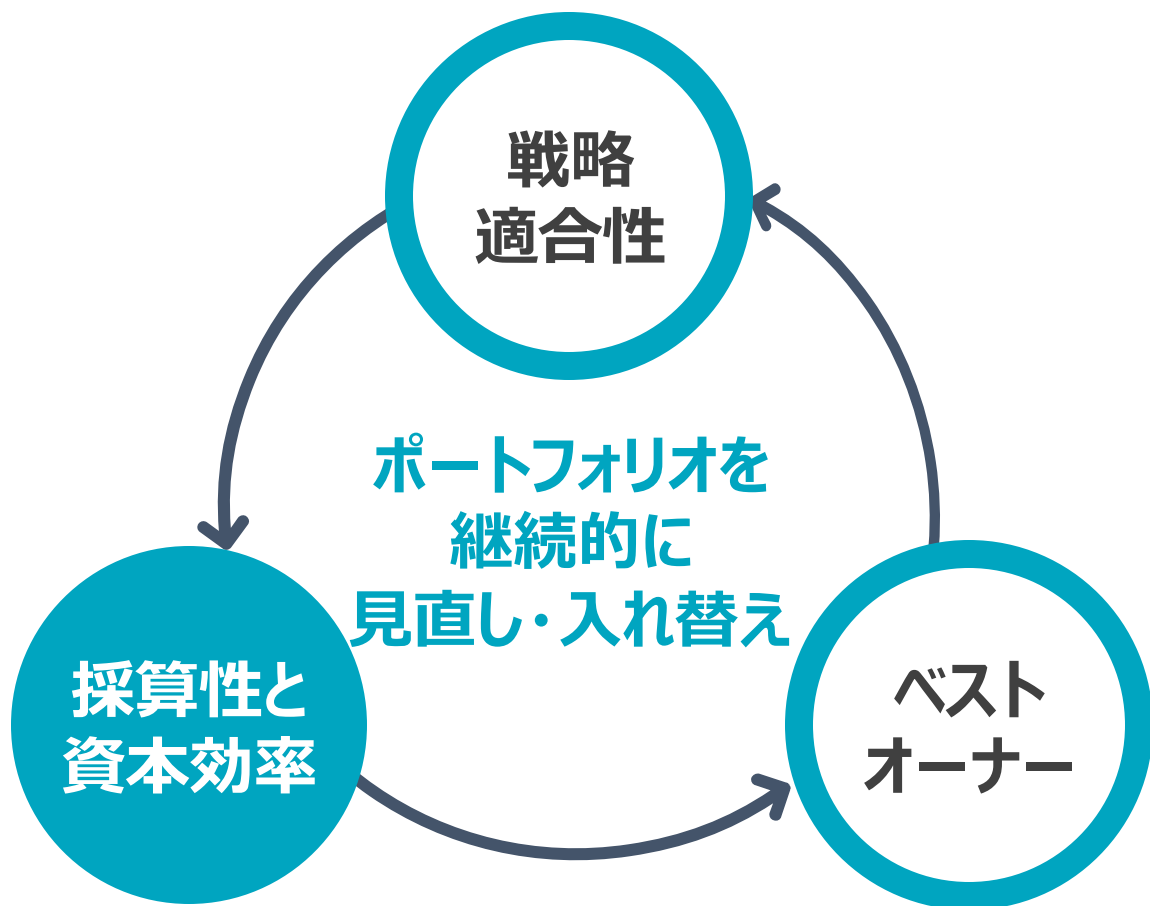


Agenda

- ① レゾナックのめざす姿
- ② 半導体成長分野への積極投資
- ③ 共創型イノベーション創出加速
- ④ カルチャー変革&人材開発
- ⑤ 資本効率経営と事業最適化

RESONAC

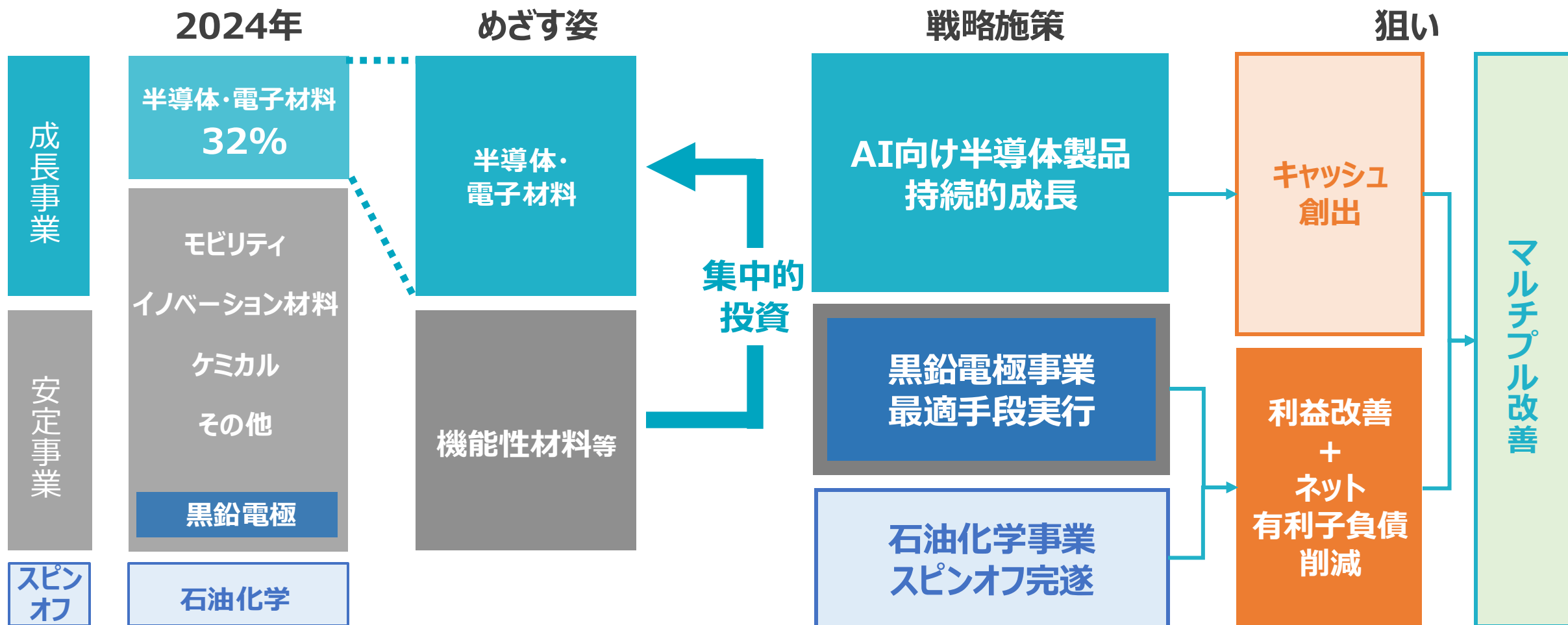
戦略的な選択と集中で資本効率を向上 成長基盤をさらに強化



- | | |
|-------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 昭光通商(商社：化学品などの販売) ・ アルミ缶事業 ・ 食品包装用ラップフィルム事業 ・ アルミ圧延品事業 ・ プリント配線板事業 ・ 蓄電デバイス・システム事業 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ・ セラミック事業 ・ ISOLITE(自動車等の断熱部品事業) |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 診断薬事業 |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 再生医療事業 ・ 表面保護用フィルム事業 |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> ・ レゾナック・パッケージング(食品等の包装材料事業) ・ クリーンエス昭和(排ガス処理事業) |
| 2026~ | <ul style="list-style-type: none"> ・ クラサケミカル(石油化学事業)の
パーシャルスピノフ(予定) |

ポートフォリオビジョン

実行へのステップ



事業特性に応じた集中と最適化の推進

蓋然性を高める集中的な取り組み推進

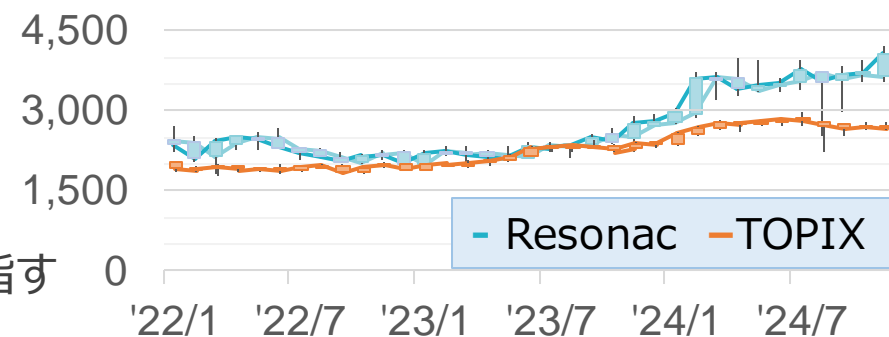
資本政策

■ 成長投資を最優先

①営業CFの1/2～2/3を設備投資へ、②半導体に集中投資

■ TSR（株主総利回り）の重視

当面、希薄化を伴う資本調達を行わず、キャピタルゲイン拡大を目指す



RESONAC発足時(2022年12月決算)

■ コングロマリット企業体として発足

キャッシュ
創出

売上 **1.4**兆円×EBITDA **12%**

マルチプル

EV/EBITDA倍率 **7.4** 倍

ネット
有利子負債

8,790億円

実績

株価：**2,020**円

時価総額：**3,659**億円



めざす姿

■ PF改革・資本政策推進で利益率・マルチプル向上

キャッシュ
創出

売上 **1**兆円超×EBITDA **20%** (目標)

マルチプル

EV/EBITDA倍率 **15**倍(目標)

ネット
有利子負債

適正水準維持

理論値

株価：**1**万円

時価総額：**2**兆円

Say & Do

半導体成長分野への積極投資

共創型イノベーション創出加速

カルチャー変革&人材開発



市場環境の改善と機会の活用

内部効率化

ポートフォリオの最適化

めざす姿

売上高
1兆円超

EBITDA
20%

PBR
1倍超

2024

1.4兆円

13.7%

1.1倍

2023

1.3兆円

8.2%

0.9倍

RESONAC

Chemistry for Change

注意事項

本資料に掲載されている当社の業績に関する予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、世界的な政治情勢、経済情勢、規制の強化、製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。